

公司代码：603005

公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	胡译
电话	0512-67730001	0512-67730001
传真	0512-67730808	0512-67730808
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减 (%)	2012年末
总资产	2,048,488,734.82	1,070,182,076.92	91.41	691,651,802.26
归属于上市公司 股东的净资产	1,572,291,922.29	750,777,560.89	109.42	627,079,932.87
	2014年	2013年	本期比上年同期 增减 (%)	2012年
经营活动产生的 现金流量净额	239,583,810.31	203,819,606.97	17.55	147,500,362.37

营业收入	615,810,322.31	450,433,205.85	36.72	337,332,771.27
归属于上市公司股东的净利润	196,310,877.99	153,732,160.74	27.70	137,911,768.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,551,525.92	145,032,038.73	15.53	128,650,407.06
加权平均净资产收益率(%)	13.69	20.94	减少7.25个百分点	22.31
基本每股收益(元/股)	0.88	0.81	8.64	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.81	8.64	0.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				9,626		
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）				13,801		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD	境外法人	25.21	57,160,964	57,160,964	无	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	24.28	55,048,276	55,048,276	无	
OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) COMPANY LIMITED	境外法人	13.35	30,261,687	30,261,687	无	
英菲尼迪—中新创业投资企业	其他	5.93	13,449,638	13,449,638	无	
西南证券股份有限公司	未知	1.81	4,108,921		未知	
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.69	3,826,731	3,826,731	无	
GILLAD GAL-OR	境外自然人	1.56	3,530,530	3,530,530	无	
苏州豪正企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.43	3,236,688	3,236,688	无	
丁惠莲	境内自然人	0.80	1,812,424		未知	
中国农业银行—交银施罗德 精选股票证券投资基金	未知	0.78	1,776,562		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、公司不存在控股股东情况的特别说明

截至报告期末，公司股权结构较为分散，第一大股东 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 和第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持股比例分别为 25.21% 和 24.28%，无任何股东直接持股比例高于 50%，且股东间不存在一致行动的情形，因此公司无控股股东。

（二）实际控制人情况

2、公司不存在实际控制人情况的特别说明

由于公司的股权结构、董事会构成特点，无任何单一股东对公司的经营方针及重大事项的决策能够决定和作出实质影响，并且股东之间不存在一致行动情形，因此，公司无实际控制人。

① 公司董事会构成情况。公司董事会由 9 名董事组成，Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 委派一名、中新苏州工业园区创业投资有限公司委派两名，Omnivision Holding(Hong Kong) Company Limited 和英菲尼迪-中新创业投资企业各委派一名，还有一名为共同委派，其余三名为独立董事，各股东在董事会席位上的分配比较均衡。单一股东在公司董事会所占席位均未过半，无单一股东对董事会有实质影响，单一股东对公司董事会均不构成实际控制。

② 公司股权情况。根据《公司法》及公司章程的规定，股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。截至报告期末，公司共有 10 名股东，股权结构较为分散，第一大股东 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 和第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持股比例分别为 25.21% 和 24.28%，无任何股东直接持股比例高于 50%。虽然中新苏州工业园区创业投资有限公司及其全资子公司华圆管理咨询（香港）有限公司持有 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 28.28% 的股权；中新苏州工业园区创业投资有限公司持有英菲尼迪-中新创业投资企业 49.50% 股权，同时持有英菲尼迪-中新创业投资企业的必备投资者华亿创业投资管理（苏州）有限公司 50% 的股权；中新苏州工业园区创业投资有限公司的控股股东苏州元禾控股有限公司持有苏州德睿亨风创业投资有限公司 29.00% 股权。但中新苏州工业园区创业投资有限公司对 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.、英菲尼迪-中新创业投资企业、苏州德睿亨风创业投资有限公司均无实际控制权。

因此，中新苏州工业园区创业投资有限公司及其子公司、控股股东在公司其他股东中持股不会影响到中新苏州工业园区创业投资有限公司作为公司股东的实际表决权；公司各股东均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；其各自亦与其他公司股东之间不存在通过协议、其他安排，与其他股东共同扩大其所能支配的公司股份表决权数量的行为或者事实。因此，单一股东对公司的普通及重大决议均不产生实质影响，公司无控股股东，无实际控制人

三 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

受益于全球经济趋稳回升、消费电子产品需求增加、以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端持续增长，以及物联网、可穿戴产品的开始崛起，2014 年我国集成电路市场规模保持持续增长，全年集成电路产业销售额为 3015.4 亿元，同比增长 20.2%。其中，设计业增速最快，销售额为 1,047.4 亿元，同比增长 29.5%；制造业销售额达 712.1 亿元，增长率为 18.5%；封

装测试业销售额 1,255.9 亿元，同比增长 14.3%。

在此背景下，2014 年公司专注于传感器领域的封装业务，把握 CMOS、生物身份识别、MEMS 等芯片领域发展的有利时机，积极扩充封装产能，坚持技术持续自主创新，不断拓展市场与技术应用领域，促进了公司产能的有效释放、实现 12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术的成功量产和生物身份识别芯片封装量的稳步提升，并使公司全年保持了持续的增长态势。报告期内，公司实现销售收入 61,581.03 万元，同比增长 36.72%，实现营业利润 19,556.37 万元，同比增长 14.01%，实现净利润 19,631.09 万元，同比增长 27.7%。

（二）主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	615,810,322.31	450,433,205.85	36.72
营业成本	294,256,013.45	196,946,069.66	49.41
销售费用	1,971,619.02	1,703,091.50	15.77
管理费用	132,718,524.73	73,985,784.13	79.38
财务费用	-7,924,590.80	1,503,726.59	-627.00
经营活动产生的现金流量净额	239,583,810.31	203,819,606.97	17.55
投资活动产生的现金流量净额	-307,520,967.65	-182,661,401.79	-68.36
筹资活动产生的现金流量净额	613,586,119.11	-11,634,520.07	5,373.84
研发支出	103,985,016.33	47,898,158.97	117.10

2 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况 说明
货币资金	806,831,572.60	39.39	246,888,817.06	23.07	226.80	-
应收账款	93,097,014.02	4.54	53,071,821.92	4.96	75.42	-
预付款项	7,313,431.06	0.36	2,727,851.99	0.25	168.10	-
其他应收款	1,672,974.49	0.08	2,491,447.18	0.23	-32.85	-
存货	56,195,493.58	2.74	35,824,876.75	3.35	56.86	-
其他流动资产	94,488,619.00	4.61	9,033,979.26	0.84	945.92	-
可供出售金融资产	10,440,748.50	0.51			-	-
固定资产	862,923,517.65	42.12	440,326,670.83	41.15	95.97	-
在建工程	106,770,833.79	5.21	256,227,487.49	23.94	-58.33	-
递延所得税资产	2,569,094.79	0.13	948,209.77	0.09	170.94	-
其他非流动	2,316,592.00	0.11	19,475,243.88	1.82	-88.10	-

资产						
应付账款	239,197,953.48	11.68	161,946,122.29	15.13	47.70	-
预收款项	2,477,262.52	0.12				-
应付职工薪酬	26,662,249.71	1.30	12,110,953.10	1.13	120.15	-
应交税费	3,593,011.97	0.18	7,037,961.88	0.66	-48.95	-
其他应付款	73,271,560.93	3.58	3,569,352.92	0.33	1,952.80	-
资本公积	813,911,423.91	39.73	183,750,259.15	17.17	342.94	-
其他综合收益	-8,224,620.85	-0.40	-74,527.75	-0.01	10,935.65	-
盈余公积	68,056,335.09	3.32	47,963,896.85	4.48	41.89	-
未分配利润	471,851,829.14	23.03	329,637,932.64	30.80	43.14	-

（三）核心竞争力分析

1、技术先进性

晶圆级芯片尺寸封装技术的特点是在晶圆制造工序完成后直接对晶圆进行封装，再将晶圆切割分离成单一芯片，封装后的芯片与原始裸芯片尺寸基本一致，符合消费类电子短、小、轻、薄发展的需求和趋势。作为一种新兴的先进封装技术其具有成本优势和产业链优势，随着消费电子对尺寸、性能 and 价格的需求日益提升，晶圆级芯片尺寸封装技术已成为主流的封装方式之一。目前，全球只有少数公司掌握了晶圆级芯片尺寸封装技术，公司作为晶圆级芯片尺寸封装技术的市场领先与技术引领者，具有技术先发优势与规模优势。

2、技术持续自主创新

公司具备技术持续创新、并将创新技术推向市场的核心能力。在技术自主创新中，公司技术储备日益多样化，应用领域更加宽广。除了引进的光学型晶圆级芯片尺寸封装技术、空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术，公司自主开发了超薄晶圆级芯片尺寸封装技术、硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术，应用于MEMS、生物身份识别系统、发光电子器件的晶圆级芯片尺寸封装技术等，这些技术广泛应用于影像传感芯片、环境光感应芯片、医疗电子器件、微机电系统、生物身份识别芯片、射频识别芯片等众多产品，为公司的发展奠定了坚实的技术保障。2014年公司独立自主开发的12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术成功实现量产，并建成全球第一条、也是当前唯一一条12英寸晶圆级芯片尺寸先进封装生产线，该技术的领先性与唯一性将进一步提升公司的市场与技术领先优势。

3、市场与产业优势

作为晶圆级芯片尺寸封装技术这一新兴技术的实践者，公司坚持以技术创新为切入点，努力培育、发展市场与客户，推广、统一产业链工艺标准。在技术持续发展与更新的推动下，公司成功开发CMOS、MEMS、生物身份识别、智能卡等应用市场，拓展了自身核心客户群体，实现了公司与WLCSP技术、市场、客户的共同成长，并成为市场规模最大的公司。与产业链共同成长的发展模式将进一步推动公司保持技术的先进性与领先性、提升市场规模优势、开发新兴应用市场、稳定、培育核心客户群体。

（四）公司发展战略

公司将坚持以做强和做大为根本出发点，立足于为大众消费市场提供领先的小型化技术服务，坚持技术的持续自主创新，通过机制优化、制度建设、环境创造，强化公司的创新和和谐氛围，不断激发员工的创造性和积极性，不断加强自身在封装领域的核心竞争力；同时坚持以市场为导向，

持续开发多样化的晶圆级芯片尺寸封装技术，引领技术发展趋势。不断拓广市场应用领域，与上下游产业链共同成长。加强内部管理，提高运营效率，使公司在技术创新、市场发展、内部管理等保持均衡发展。与此同时，公司将注重自身的社会责任，以优异经营成果回报客户、供应商、员工、股东与社会，努力使公司成为全球一流的半导体封装测试服务提供商。

（五）经营计划

2015 公司继续以“执着、务实、创新、共赢”的发展理念，持续提升封装技术能力，为客户提供多样化的增值封装服务。

1、有效释放产能：在完成“先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目”建设工作的基础上，有效释放项目产能，保证公司封装能力与技术工艺能力的持续提升；

2、加大技术的持续创新投入。持续提升 12 寸晶圆级芯片尺寸封装的技术与工艺水平，深化 TSV 封装技术、生物身份识别封装技术、MEMS 封装技术的研发与工艺提升，积极发挥收购新增封装测试资产与工艺的作用，并有效融合晶圆级封装技术与传统封装测试工艺及先进倒装工艺，突破公司技术能力限制，进行技术与工艺的专利布局，保持公司技术能力的领先型、创新型、全面型。

3、积极拓展市场应用领域。持续以 CMOS 市场领域为抓手，顺应智能手机、平板电脑等消费电子市场的持续增长与不断提升的工艺需求，以技术持续创新为切入点来满足客户需求，并加强新客户的推广与开发力度。进一步拓展 CMOS 产品在安防、医疗、汽车电子、物联网领域的应用与推广，塑造市场新增长点；持续加大对 MEMS、生物身份识别等新兴应用市场的开发与推广，与上下游合作方共同打造新的产业链条与合作模式，为公司未来的持续发展奠定新的动力。

（六）可能面对的风险

1、行业波动风险

集成电路行业具有技术和市场呈周期性波动的特点。2002年到2004年，全球半导体行业处于高速增长阶段，2005年出现周期性回落，增长速度从2004年的38%下降到6.8%，之后2006年和2007年增速一直保持较低的水平，2008年和2009年受金融危机的影响，甚至出现了负增长，2010年触底反弹，强劲复苏，2011年到2012年受欧债危机影响，市场需求低迷，行业处于低位徘徊。2013年以来，全球半导体行业处于缓慢复苏。行业与市场的周期性波动，可能对公司经营造成不利影响。

2、技术产业化风险

为顺应市场发展需求，拓广技术和产品的应用领域，公司持续开发了多样化的封装技术。由于集成电路行业技术更新快，研发投入大，创新技术的产业化需要产业链的共同配合，因而，公司技术和工艺的产业化存在一定的不确定性风险。

3、汇率波动风险

公司产品出口比例较高，主要以美元作为结算货币；原材料也部分从国外采购，主要以美元和欧元作为结算货币。自 2005 年 7 月 21 日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币总体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。如果人民币汇率变动幅度较大，将会对公司的经营产生一定的不利影响。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1、2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）等 8 项会计准则的相关规定在 2014 年 7 月 1 日（首次执行日）已对本公司财务报表重新列报，并对 2014 年财务报表的比较数据进行了追溯调整。本次执行前述会计准则不涉及追溯调整。

2、根据《财政部关于印发修订的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目。2014 年 4 月，公司出资 2000 万人民币对华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行投资，并计入到长期股权投资科目，公司将该项长期股权投资调整为可供出售金融资产，该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司本期资产总额、负债总额和净资产以及本期净利润未产生影响。

董事长：王蔚
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2015 年 4 月 10 日